

# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

2000200940

PUBLICATION DATE

18-07-00

APPLICATION DATE

05-01-99

APPLICATION NUMBER

11000362

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

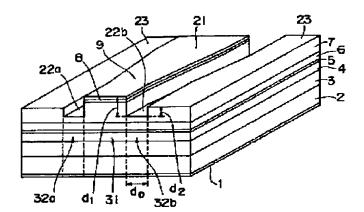
INVENTOR: SHIGIHARA KIMIO;

INT.CL.

H01S 5/065 H01S 5/22 H01S 5/323

TITLE

SEMICONDUCTOR LASER DIODE



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable making into singleness of transverse mode by providing a low refractive index region having a third refractive index, which is smaller than first and second refractive indexes in each space between an active region and a clad region, and setting a width of an active region and a width of a low refractive index region to form a cut-off region.

SOLUTION: In a wide portion in an active region 31, light is confined in the active region 31 not only in basic mode but also in higher order modes. Meanwhile, in a narrow portion of the active region 31, light expands also to an outside of the active region 31 and is influenced strongly by a clad region 23 positioned outside low refractive index regions 32a, 32b, and therefore although basic mode of laser beam propagates, higher order mode thereof cannot propagate. Oscillation of higher order mode can be restrained and oscillation at single mode is possible by setting a width of the active region 31 and a width of the low refractive index regions 31a, 31b to allow formation of a cut-off region, wherein higher order mode cannot propagate in a part of the active region 31.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-200940 (P2000-200940A)

(43)公開日 平成12年7月18日(2000.7.18)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード( <i>参考</i> )
H01S	5/065		H01S	3/18	634	5 F O 7 3
	5/22	•			662	
	5/323				673	

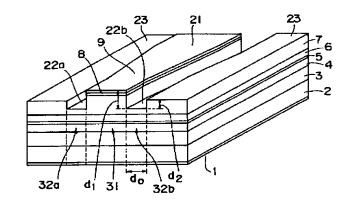
		審査請求	未請求	請求項の数7	OL	(全	7	頁)
(21)出願番号	特顧平11-362	(71)出顧人	0000060	)13 發株式会社				
(22) 出顧日	平成11年1月5日(1999.1.5)	(72)発明者 (74)代理人 Fターム(参	東京都 場原 ネ 東京都 菱電機材 1000621 弁理士	千代田区丸の内	二丁目: 外1名) AA89 BA	2番3 .02 CA	号 .07	Ξ

#### (54) 【発明の名称】 半導体レーザダイオード

## (57)【要約】

【課題】 横モードの単一化が図れかつ高出力化が可能 な半導体レーザダイオードを提供する。

【解決手段】 共振方向に長手方向が一致しかつレーザ 光の基本モードに対する実効的な屈折率より大きい第1 の屈折率を有する活性領域と、活性領域の両側に第2の 屈折率を有するクラッド領域とを並置して形成すること により活性領域に光を閉じ込めるようにし、活性領域と クラッド領域の各間に第1と第2の屈折率より小さい第 3の屈折率を有する低屈折率領域を設けかつ、活性領域 の一部に半導体レーザダイオードが発振するレーザ光の 基本モードを伝播させかつ高次モードの伝播を阻止する カットオフ領域が形成されるように、活性領域の幅と上 記低屈折率領域の幅とを設定した。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 共振方向に長手方向が一致しかつレーザ 光の基本モードに対する実効的な屈折率より大きい第1 の屈折率を有する活性領域と、上記活性領域の両側に第 2の屈折率を有するクラッド領域とを並置して形成する ことにより上記活性領域に光を閉じ込めるようにした半 導体レーザダイオードであって、

上記活性領域と上記クラッド領域の各間にさらに上記第 1と第2の屈折率より小さい第3の屈折率を有する低屈 折率領域を設けかつ、上記活性領域の一部に上記レーザ 光の基本モードを伝播させかつ高次モードの伝播を阻止 するカットオフ領域が形成されるように、上記活性領域 の幅と上記低屈折率領域の幅とを設定したことを特徴と する半導体レーザダイオード。

【請求項2】 上記活性領域は、幅が徐々に減少するように形成されたテーパ部を有している請求項1記載の半導体レーザダイオード。

【請求項3】 半導体基板上に、下クラッド層と、上クラッドと、上記上クラッド層と上記下クラッド層との間に位置する活性層とを含む複数の半導体層が積層されてなり、該積層された半導体層においてそれぞれ上記上クラッド層の途中まで達しかつ一端から他端に至る2つの満を形成することによりリッジ部を形成した半導体レーザダイオードであって、

上記リッジ部の一部又は全部を徐々に幅が狭くなるように形成し、上記リッジ部と上記溝とを形成することにより構成される活性領域の一部に、上記半導体レーザダイオードが発振するレーザ光の基本モードを伝播させかつ高次モードの伝播を阻止するカットオフ領域が形成されるように、上記リッジ部の形状と上記溝の形状とを設定したことを特徴とする半導体レーザダイオード。

【請求項4】 上記2つの溝の幅をそれぞれ、上記一端面から他端面に至るまで一定になるように形成した請求項3記載の半導体レーザダイオード。

【請求項5】 上記各溝の外側に位置するクラッド領域の上面と上記リッジ部の上面とが実質的に同一平面上に位置する請求項3又は4に記載の半導体レーザダイオード。

【請求項6】 上記リッジ部の上面が、上記各溝の外側に位置するクラッド領域の上面より高くなるように形成されている請求項3又は4に記載の半導体レーザダイオード。

【請求項7】 上記リッジ部は一端面の幅が他端面の幅 より広くなるように形成され、上記一端面から光を出力 するようにした請求項3~6のうちのいずれか1項に記 載の半導体レーザダイオード。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主として情報処理 あるいは光通信等の光源として用いられる半導体レーザ ダイオードに関する。

#### [0002]

【従来の技術】情報処理又は光通信の光源として半導体レーザダイオードが使用されている。これらの用途に使用される半導体レーザダイオードでは、ビーム形状を安定させるために横モードを単一モード化しておく必要がある。横モードを単一化するためには、活性領域をその活性領域より屈折率の低い領域で挟んで活性領域の幅をある一定以下に制限する必要があり、この活性領域の幅をある一定以下に制限する必要があり、この活性領域の幅をある一定以下に制限する必要があり、この活性領域の幅を形成する構造が、比較的簡単で安価に製造することができることから、広く用いられている。この構造は、半導体レーザダイオードの共振方向に、所定の幅のリッジ部を形成することにより、所定の幅のリッジ部を形成することにより、活性領域の幅を制限して横モードを単一化するものである。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の リッジ部を形成して活性領域の幅を制限する半導体レー ザダイオードでは、横モードの単一化を図るために活性 領域の幅を比較的狭くする必要があり、その結果、狭い 活性領域に光のエネルギーを集中させることになるの で、高出力化が困難であるという問題点があった。

【0004】そこで、本発明は、従来例の問題点を解決して、横モードの単一化が図れかつ高出力化が可能な半導体レーザダイオードを提供することを目的とする。

### [0005]

【課題を解決するための手段】以上の目的を達成するた めに、本発明に係る第1の半導体レーザダイオードは、 共振方向に長手方向が一致しかつレーザ光の基本モード に対する実効的な屈折率より大きい第1の屈折率を有す る活性領域と、上記活性領域の両側に第2の屈折率を有 するクラッド領域とを並置して形成することにより上記 活性領域に光を閉じ込めるようにした半導体レーザダイ オードであって、上記活性領域と上記クラッド領域の各 間にさらに上記第1と第2の屈折率より小さい第3の屈 折率を有する低屈折率領域を設けかつ、上記活性領域の 一部に上記半導体レーザダイオードが発振するレーザ光 の基本モードを伝播させかつ高次モードの伝播を阻止す るカットオフ領域が形成されるように、上記活性領域の 幅と上記低屈折率領域の幅とを設定したことを特徴とす る。このようにすると、上記カットオフ領域において上 記高次モードの伝播を阻止できるので、横モードを単一 化することができる。尚、本明細書において、単に基本 モード、1次モード、高次モードというときは、特にこ とわらない限り、横モードについて言うものとする。 【0006】また、本発明に係る第1の半導体レーザダ イオードでは、上記活性領域は、幅が徐々に減少するよ うに形成されたテーパ部を有していることが好ましい。

【0007】また、本発明に係る第2の半導体レーザダ

イオードは、半導体基板上に、下クラッド層と、上クラ ッドと、上記上クラッド層と上記下クラッド層との間に 位置する活性層とを含む複数の半導体層が積層されてな り、該積層された半導体層においてそれぞれ上記上クラ ッド層の途中まで達しかつ一端から他端に至る2つの溝 を形成することによりリッジ部を形成した半導体レーザ ダイオードであって、上記リッジ部の一部又は全部を徐 々に幅が狭くなるように形成し、上記リッジ部と上記溝 とを形成することにより構成される活性領域の一部に、 上記半導体レーザダイオードが発振するレーザ光の基本 モードを伝播させかつ高次モードの伝播を阻止するカッ トオフ領域が形成されるように、上記リッジ部の形状と 上記溝の形状とを設定したことを特徴とする。このよう にすると、上記カットオフ領域において上記高次モード の伝播を阻止できるので、横モードを単一化することが できる。

【0008】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードでは、上記2つの溝の幅をそれぞれ、上記一端から他端に至るまで一定になるように形成することが好ましい。これによって、リッジ部の形状の設計が容易となる。

【0009】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードでは、上記各溝の外側に位置するクラッド領域の上面と上記リッジ部の上面とが実質的に同一平面上に位置するように構成することが好ましく、このようにすると、1度のエッチングで溝を形成することにより構成でき、製造工程を簡略化できる。

【0010】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードでは、上記リッジ部の上面が、上記各溝の外側に位置するクラッド領域の上面より高くなるように形成してもよく、このようにすると、上記活性領域に効果的に光を閉じ込めることができる。

【0011】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードでは、上記リッジ部は一端面の幅が他端面の幅 より広くなるように形成され、上記一端面から光を出力 するようにすると、高出力化に有利であり好ましい。

# [0012]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明に係る実施の形態の半導体レーザダイオードについて説明する。本実施の形態の半導体レーザダイオードは、下面に n側電極が形成された n型G a A s 基板 2 上に、n型A 1 G a A s クラッド層3、アンドープA 1 G a A s グラッド層6、アンドープA 1 G a A s ガイド層6、p型A 1 G a A s グラッド層7及びp型G a A s コンタクト層8を含む半導体層が積層されたリッジ部21を備え、リッジ部21の上にp側電極9が形成されてなる。また、本実施の形態の半導体レーザダイオードは、リッジ部21及びリッジ部21の下に位置する半導体層によって構成される活性領域の横方向に光を閉じ込めるために、活性領域の両側に該活性

領域より屈折率の小さいクラッド領域23を有し、かつ クラッド領域23と活性領域の間にそれぞれ、1対の溝 22a、22bが形成されることにより構成された、ク ラッド領域23よりさらに屈折率の低い低屈折率領域3 2a、32bとを有する。

【0013】ここで、リッジ部21は、一方の端面104における幅Tfが他方の端面105における幅Trに比較して大きくなるように、テーパ部21bを有し、少なくとも他方の端面105側の活性領域では高次モードの伝播を阻止するように形成したことを特徴とし、これによって高次モードのレーザ発振を抑圧でき、基本モードのみのレーザ発振を可能にしている。

【0014】すなわち、実施の形態の半導体レーザダイ オードを作成する場合、まず、下面にn側電極が形成さ れたn型GaAs基板2上に、(1)n型A1GaAs クラッド層3を形成ための、例えば厚さが1~2μmの n型A 1<sub>0.5</sub>G a<sub>0.5</sub>A s 半導体層、(2) アンドープA IGaAsガイド層4を形成するための、例えば厚さが O. 1~O. 2μmのA 1<sub>0.3</sub>G a<sub>0.7</sub>A s 半導体層、 (3)アンドープ In GaAs 活性層5を形成するため の、例えば、厚さが $0.01\sim0.02\mu m O I n_{0.2}$ Gans As半導体層、(4)アンドープA1GaAs ガイド層6を形成するための、例えば厚さが0.1~ 2μmのA1<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As半導体層、(5)p型 A1GaAsクラッド層7を形成するための、例えば厚 さが1~2μmのA 1<sub>0.5</sub>G a<sub>0.5</sub>A s 半導体層、(6) p型GaAsコンタクト層8を形成するための、例えば 厚さが1μmのp型GaAs半導体層、を順次、有機金 属気相成長(MOCVD)法を形成する。

【0015】次に、リッジ部21となる部分の両側の半導体層を、p型A1GaAsクラッド層7を形成するためのA1<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As半導体層の途中(クラッド領域23の上面)まで1回目のエッチングを行う。その後、リッジ部21の両側に溝22a、22bを形成するために、p型A1GaAsクラッド層7を形成するためのA1<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As半導体層の途中(溝22a、22bの底面)まで、2回目のエッチングを行う。尚、本エッチングは、通常リッジ部を形成するために用いられる方法を用いることができ、ウェット又はドライエッチングのいずれを用いてもよい。また、本実施の形態において、溝22a、22bの幅は、長手方向のいずれの部分でも同じ幅d0となるように形成される。

【0016】ここで、本実施の形態において、リッジ部21は前端面104側に位置する幅広部21aと後端面105側に位置する幅狭部21cと、幅広部21aと幅狭部21cとの間に位置するテーパ部21bとを有し、各部の幅は以下のように設定される。すなわち、本実施の形態では、幅狭部21cと該幅狭部21cの直下とによって構成される光導波路が、レーザ発振における基本モードのみを伝送させ1次モード以上の高次モードが伝

播できないように、幅狭部21cの幅は設定され、幅広部21aの幅は高出力化を図るために、比較的広い幅に設定される。例えば、発振波長が1μ程度の半導体レーザダイオードを構成する場合、前端部104における幅広部21aの幅下fは、例えば7μ程度に設定し、後端面105の幅狭部21cの幅は、例えば3.5μ程度に設定すると、高次モードの発振を効果的に抑制し、かつ高出力化が図れる。

【0017】詳細に説明すると、実施の形態の半導体レーザダイオードでは、

リッジ部21における屈折率:na、

クラッド領域23における屈折率: nc、

低屈折率領域32a,32bの屈折率:n1、

活性領域内における基本モードの伝播定数: $\beta_0$ 、

活性領域内における1次モードの伝播定数: $\beta_1$ 、

レーザ発振光の自由空間における波数: k<sub>0</sub>

【0018】ここで、 $\beta_0/k_0$ は、基本モードに対する 実効的な屈折率であり、 $\beta_1/k_0$ は、1次モードの実効的な屈折率である。尚、 $nc<\beta_0/k_0<$ na及び $n1<\beta_1/k_0<$ ncを満足する条件は、横モードの基本モードを伝播させ、横モードの1次以上の高次モードを伝播させないようにする条件である。すなわち、 $nc<\beta_0/k_0<$ na及び $n1<\beta_1/k_0<$ ncの双方を満足する領域は、横モードの基本モードを伝播させ、横モードの1次以上の高次モードを伝播させないカットオフ領域が満足すべき条件である。

【0019】以上のようにリッジ部21の幅をテーパ状 に変化させると、すなわち、活性領域の幅をテーバ状に 変化させると、図2に模式的に示すように、活性領域3 1において幅の広いところ(例えば、図中20で示す部 分)では、基本モードBだけではなく高次モード (1次 モードS1)も活性領域31に閉じ込められる。一方、 活性領域31の幅の狭いところ(nc<βゥ/kゥ<na 及び $n \mid 1 \leq \beta_1 / k_0 \leq n c$ を満足する部分、例えば、図 中21で示す部分)では、光は活性領域31の外にも広 がり、低屈折率領域32a,32bの外側に位置するク ラッド領域23の影響を強く受けるようになるので、基 本モードBは伝播するが、1次モードS1及びそれ以上 の高次モードは伝播できなくなる。このように、前端面 104と後端面105との間を光が往復するレーザダイ オードでは、活性領域の一部において、高次モード(1 次モードを含む)が伝播することができないカットオフ 領域を設けると、高次モードはレーザ発振条件を満足し なくなり、その結果、基本モードのみで発振させること

が可能となる。

【0020】以上のように構成された実施の形態の半導体レーザダイオードは、後端面105側に位置する活性領域31の幅を基本モードのみが伝播できる幅に設定しているので、高次モードの発振を抑圧でき、単一モードで発振させることができる。また、本実施の形態の半導体レーザダイオードは、活性領域31の後端面105側に位置する一部分だけを、狭い幅にして単一モードの発振を実現しているので、その一部分を除く他の部分の幅を比較的広くできるので、高出力化が可能である。

【0021】また、以上の実施の形態の半導体レーザダイオードでは、活性領域31において一部分が高次モードに対してカットオフ領域となるようにすればよいので、比較的設計が容易である。

【0022】以上の実施の形態の半導体レーザダイオードでは、リッジ部21において、幅広部21aとテーパ部21bと幅狭部21cとを設けたが、本発明はこれに限られるものではなく、少なくとも一部の活性領域が高次モードに対してカットオフ領域となるようにリッジ部を形成するようにすれば良い。しかしながら、本発明に係る構成では、安定した発振をさせるために本実施の形態のように一部にテーパ状の部分を設けるか、又はリッジ部全体をテーパ状にする等により、徐々に幅を変化させることが好ましい。

【0023】また、本実施の形態の半導体レーザダイオ ードでは、リッジ部21の上面が、各溝の外側に位置す るクラッド領域の上面より高くなるように形成してい る。このようにすると、活性領域に効果的に光を閉じ込 めることができるので、横方向により安定した振動をさ せることができ、より安定した発振をさせることができ る。以上の実施の形態の半導体レーザダイオードでは、 低屈折率領域32a.32bの外側にクラッド領域23 を形成するようにしたが、本発明はこれに限らず、1回 のエッチングにより、溝22a, 22bを形成すること により、リッジ部21の両側に低屈折率領域32a,3 2bのみを形成するようにしてもよい(すなわち、na =ncとする。)。この場合、後端面105の部分にお いて屈折率nlが、1次モードの $\beta_1$ / $k_0$ (1次モード に対する実効的な誘電率)より小さくなるように設定す。 ることはいうまでもない。このようにクラッド領域23 を特に設けることなく構成すると、リッジ部21を形成 するためのエッチング工程を一回にでき、製造工程を簡 略化できる。尚、本実施の形態のように、リッジ部21 の上面が、クラッド領域23の上面より高くなるように 形成した場合は、活性領域に効果的に光を閉じ込めるこ とができるので、横方向により安定した振動をさせるこ とができ、より安定した発振をさせることができる。 【0024】また、本実施の形態の半導体レーザダイオ

ードは、いわゆるGaAs系半導体レーザダイオードに

限らず、InP系半導体レーザダイオード、AlGal

nP系半導体レーザダイオード及びGaN系半導体レーザダイオード等の他の半導体レーザダイオードでも同様に適用できる。

【0025】(参考例)以下、参考例としてテーパ導波路を示す。図3は、特開平1-183603で開示されたテーパ導波路の構成を模式的に示す平面図である。図3のテーパ導波路は、溝102の間に導波領域101が形成され、溝102の外側に、導波領域101より屈折率が低く溝102を形成することにより形成される低屈折率領域より屈折率の高いクラッド領域が形成されて構成されている。すなわち、テーパ導波路の断面における屈折率分布は図3の下図に示すようになる。尚、図3の下図において、 $n_{101}$ は導波領域101の屈折率を示し、 $n_{102}$ は溝102を形成することにより形成される低屈折率領域の屈折率を示し、 $n_{102}$ はクラッド領域103の屈折率を示している。

【0026】ここで、図3のテーバ導波路において、導波領域101は、前端面104における幅Tfが後端面105における幅Trに比較して大きくなるようにテーパ状に形成されている。また、溝102は、前端面104における幅dfが後端面105における幅drに比較して小さくなるようにテーバ状に形成されている。そして、図3のテーパ導波路では、導波領域101及び溝102の幅df、dr等を所定の値に設定することにより、図3のテーパ導波路では、導波路内のどの位置においても基本モードを伝播させかつ高次モードをカットするように構成されている。しかしながら、導波路内のいずれの位置においても、基本モードを伝播させかつ高次モードをカットするように各寸法を決定することは、テーパ導波路では、通常のスラブ導波路の考え方が使用できないので、設計には多くの労力を必要とし困難であった。

【0027】これに対して、本願発明の半導体レーザダイオードは、テーパ状のリッジ部21を備えるものであるが、この参考例とは異なり、導波路ではなく半導体レーザダイオードであるために、活性領域31の全ての位置で高次モードをカットする必要はなく、活性領域31の一部において高次モードをカットすることができればよい。従って、図3のテーパ導波路に比較すると本願の半導体レーザダイオードにおけるリッジ部21の形状の設計は比較的容易である。また、上述したように、本発明の半導体レーザダイオードでは、溝22a,22bを一定の幅にすることも可能であり、溝の幅を一定にするとリッジ部21の設計はさらに容易となる。

#### [0028]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係る第1の半導体レーザダイオードは、上記活性領域と、上記活性領域の両側に上記クラッド領域とを並置して形成することにより上記活性領域に光を閉じ込め、上記活性領域と上記クラッド領域の各間にさらに上記第1と第

2の屈折率より小さい第3の屈折率を有する低屈折率領域を設けかつ、上記カットオフ領域が形成されるように、上記活性領域の幅と上記低屈折率領域の幅とを設定しているので、上記カットオフ領域において上記高次モードの伝播を阻止でき横モードを単一化することができる。また、上記カットオフ領域以外の領域を比較的広くすることができるので、高出力化が可能となる。従って、本発明の第1の半導体レーザダイオードによれば、横モードの単一化が図れかつ高出力化が可能な半導体レーザダイオードを提供することができる。

【0029】また、本発明に係る第1の半導体レーザダイオードでは、上記活性領域に幅が徐々に減少するように形成されたテーパ部を形成することにより、安定したレーザ発振をさせることができる。

【0030】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードは、上記積層された半導体層において上記2つの溝を形成することにより上記リッジ部を形成し、そのリッジ部の一部又は全部を徐々に幅が狭くなるように形成し、上記リッジ部と上記溝とを形成したことにより構成される活性領域の一部に、上記カットオフ領域が形成されるように、上記リッジ部の形状と上記溝の形状とを設定したので、上記カットオフ領域において上記高次でされるように、上記カットオフ領域において上記高次できる。また、上記カットオフ領域以外の領域を比較的広くすることができるので、高出力化が可能となる。従って、本発明の第2の半導体レーザダイオードによれば、横モードの単一化が図れかつ高出力化が可能な半導体レーザダイオードを提供することができる。

【0031】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードでは、上記2つの溝の幅をそれぞれ、上記一端から他端に至るまで一定になるように形成することにより、リッジ部の形状の設計が容易となるので、設計コストを低減できる。

【0032】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードでは、上記各溝の外側に位置するクラッド領域の上面と上記リッジ部の上面とが実質的に同一平面上に位置するように構成することにより、1度のエッチングで溝を形成することにより構成できるので、製造工程を簡略化でき、製造コストを低減できる。

【0033】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードでは、上記リッジ部の上面が、上記各溝の外側に位置するクラッド領域の上面より高くなるように形成することにより、上記活性領域に効果的に光を閉じ込めることができるので、横方向により安定した振動をさせることができ、より安定した発振をさせることができる

【0034】また、本発明に係る第2の半導体レーザダイオードでは、上記リッジ部は一端面の幅が他端面の幅より広くなるように形成し、上記一端面から光を出力することにより、出射端面における破壊を効果的に防止で

き高出力化が図れる。

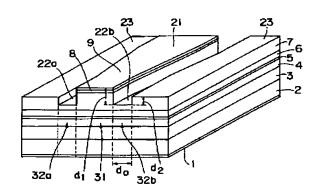
# 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る実施の形態の半導体レーザダイオードの構成を示す斜視図である。

【図2】 (a)は、実施の形態の半導体レーザダイオードの平面図であり、(b)は、実施の形態の半導体レーザダイオードの幅狭部における縦断面の屈折率分布を示す図であり、(c)は、実施の形態の半導体レーザダイオードの幅広部における縦断面の屈折率分布を示す図である。

【図3】 (a)は、参考例として示すテーパ導波路の

【図1】



平面図であり、(b)は、該テーパ導波路の幅の狭い部 分の縦断面における屈折率分布を示す図である。

# 【符号の説明】

1 n側電極、2 n型GaAs基板、3 n型A1GaAsカラッド層、4アンドープA1GaAsガイド層、5 アンドープInGaAs活性層、6 アンドープA1GaAsカイド層、7 p型A1GaAsクラッド層、8 p型GaAsコンタクト層、21 リッジ部、21a 幅広部、21b テーパ部、21c 幅狭部、22a、22b 溝、23 クラッド領域、31活性領域、32a、32b 低屈折率領域。

【図2】

